



Investor Relations 2025

## 2025년 에이엘티 CORP DAY



## Disclaimer

---

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사에이엘티(이하 "회사")에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

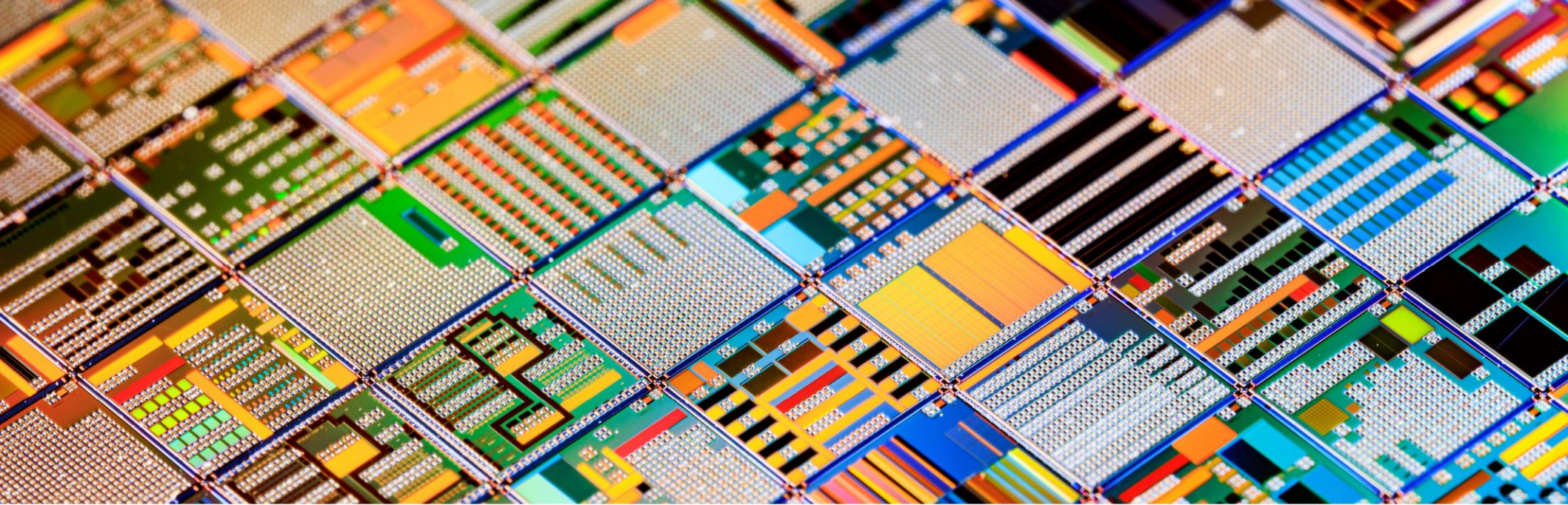
위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.





# ADVANCED LINK TECHNOLOGY

## TABLE OF CONTENTS

Chapter 01.  
회사 소개

Chapter 02.  
주요 기술력 및 경쟁력

Chapter 03.  
성장전략 및 비전

APPENDIX





## 회사소개

1. 회사개요
2. 회사연혁
3. 사업영역
4. 다양한 고객사 확보
5. 2024년 연간 실적



Chapter 01

## 01. 회사 개요

22년 업력의 비메모리 반도체 후공정 전문 기업

### 기업개요

회사명	(주)에이엘티
대표이사	천병태
설립일	2003년 7월 23일
자본금	44.8억 원
본점소재지	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19
홈페이지	www.alt-s.kr

### 대표이사



#### 천병태 CEO

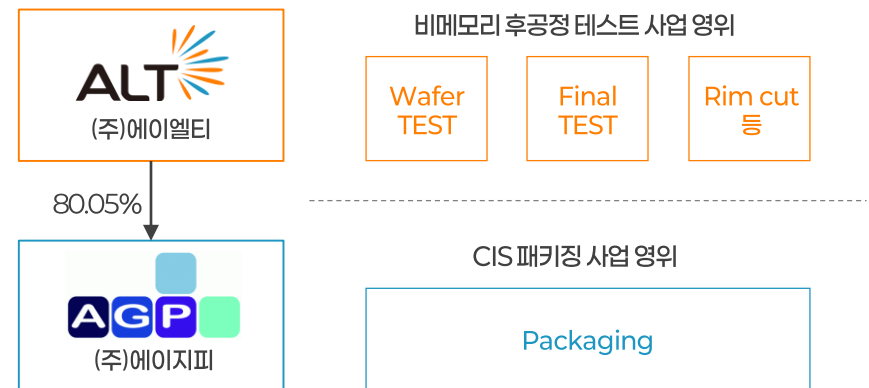
##### 경력

- 한국동경실리콘연구소
- SK하이닉스반도체제조부문 상무이사
- (주)ALT 설립/현 대표이사

##### 수상내역

- 우수중소기업인 부문 충북지방중소기업청 표창
- 혁신기업경영중소기업부문 중소기업중앙회 표창
- 모범납세자 부문 대통령 표창

### 지배구조 및 사업영역



## 02. 회사 연혁

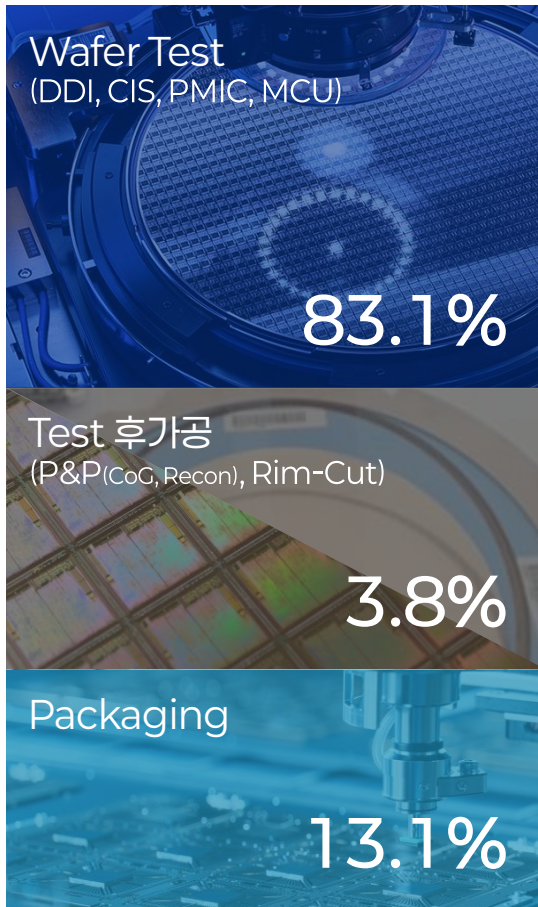
비메모리 반도체 포트폴리오가 다변화된 OSAT 전문기업으로 성장 중



### 03. 사업영역

OSAT(Wafer test + Packaging) 사업 기반 다양한 비메모리 반도체 후공정 업무 수행

#### 매출구성(2024년 기준)



#### ALT 주요 비메모리 반도체

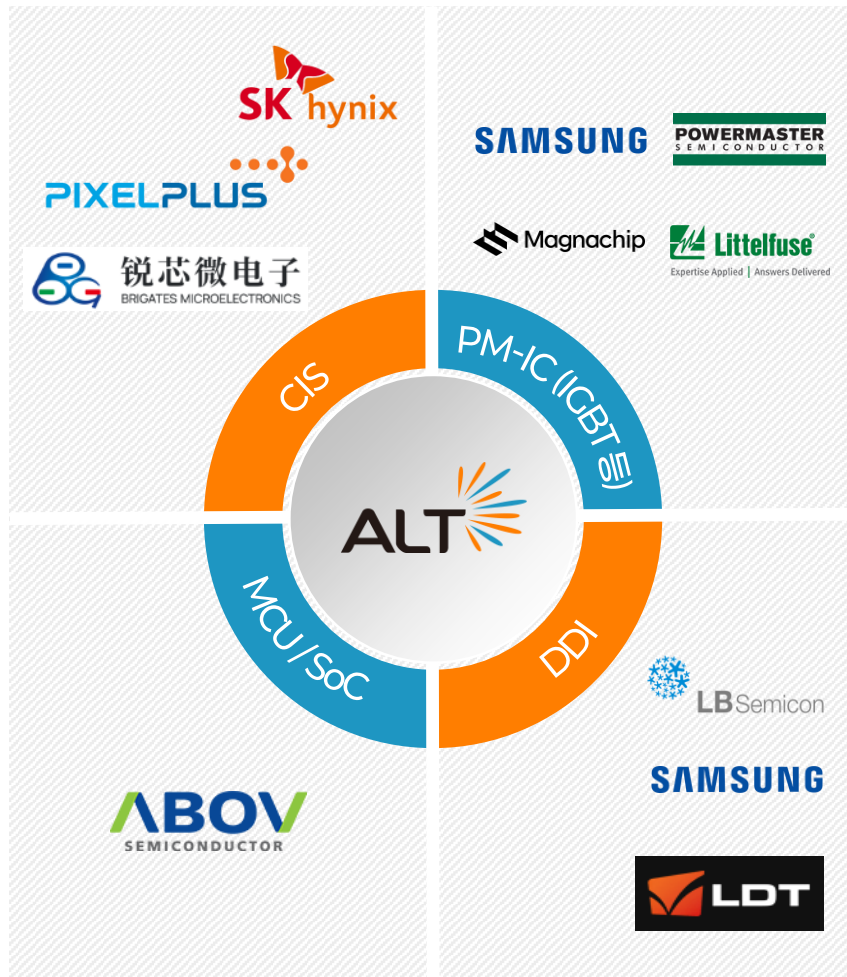
<b>DDI (Display Driver IC)</b> 각종 LCD Panel, LED, OLED 등을 구동 시키는 반도체 소자 <b>적용 산업</b> 스마트폰 TV PC 스마트워치	<b>CIS (CMOS Image Sensor)</b> 빛에너지를 전기적인 신호로 변환하는 집적회로가 내장된 이미지 센서 <b>적용 산업</b> 스마트폰 CCTV 자동차 로봇	<b>PM-IC (IGBT 등)</b> 전자기기에 필요한 전력 공급 및 효율적 관리 <b>적용 산업</b> 스마트폰 노트북 전기차 IoT
<b>MCU / SoC</b> 전자기기에 채택되는 통합 칩(SoC) 단순 동작부터 AI 등 다양한 특성을 제어 <b>적용 산업</b> 스마트폰 IoT 자율주행 스마트 팩토리	<b>M/C (Memory Controller)</b> 메모리를 관리, 제어하고 효율적인 데이터 처리를 지원하는 칩 <b>적용 산업</b> 스마트폰 PC 서버 통신장비	<b>AP (Application Processor)</b> 모바일 기기와 임베디드 시스템의 다양한 작업을 처리하는 통합 프로세서 <b>적용 산업</b> 스마트폰 스마트워치 자동차 IoT



## 04. 다양한 고객사 확보

ALT만의 차별화된 기술 제공으로 다양한 고객사 확보

### ALT 사업영역별 다양한 고객사



### 국내 유일 Rim-Cut 솔루션 제공

Laser Cut 방식의 Taiko Wafer 절단 프로세스를 자동화된 단일 공정으로 통합, Chip 수율을 향상시키는 국내 유일 솔루션



열, 스크랩에 의한  
불량 감소  
수율 극대화

단일 공정을 통한  
납기 단축

### Recon Turn-Key 서비스 제공

Wafer Test와 함께 절단 및 분리, 양품 Chip을 성능별로 재배열하는 Turn-Key 서비스 제공



고품질  
생산 시스템 구축

신속한 후속  
공정 지원

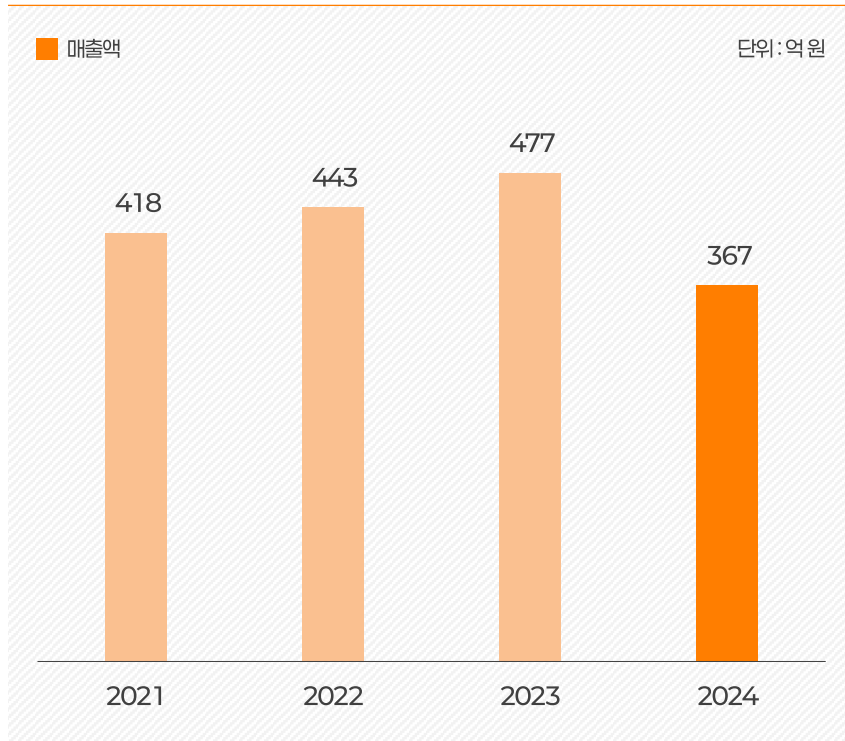


## 05. 2024년 연간 매출액

IT제품 수요 회복 지연 등 전방산업 침체로 매출액 110.2억(-23.1%) 감소

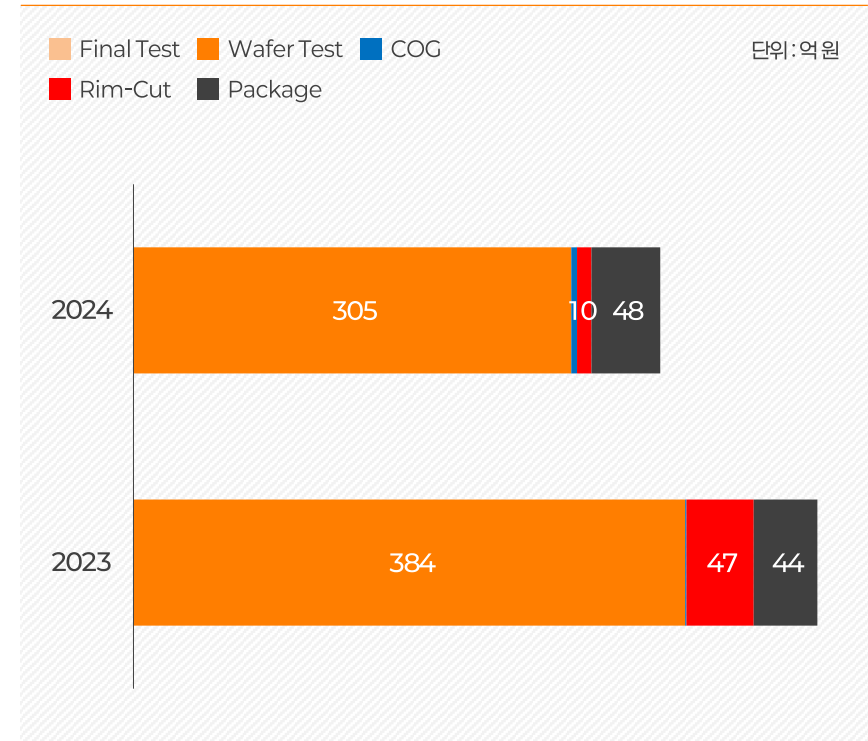
- » Test 매출 : 전년 대비 매출액 79.5억(-20.7%) 감소
- » 기타 매출 : 전년 대비 매출액 30.7억(-33.2%) 감소

### 매출액



주: K-IFRS 연결 기준

### 전년 대비 사업부별 매출액

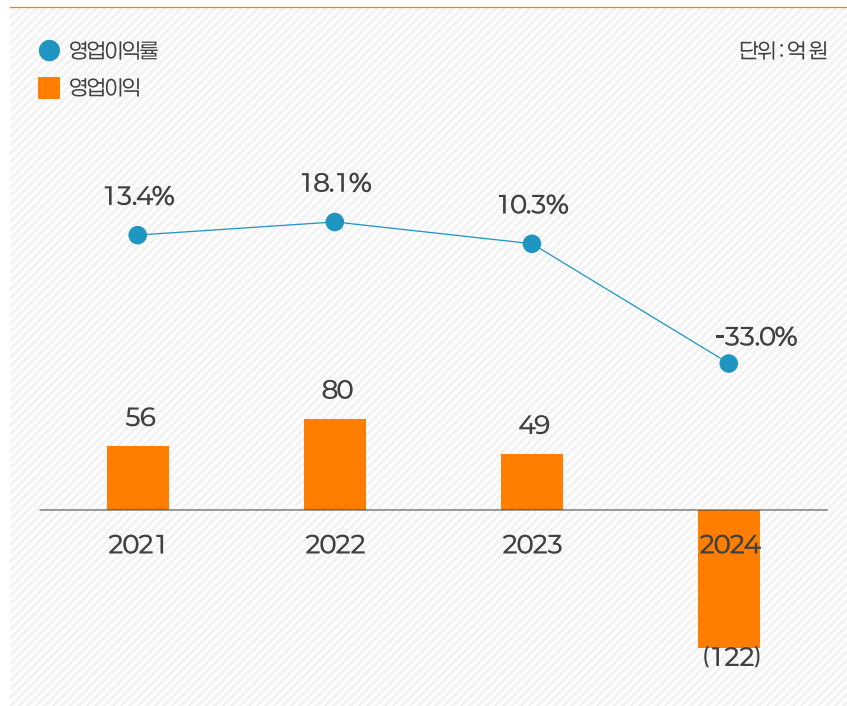


## 05. 2024년 연간 영업이익/당기순이익

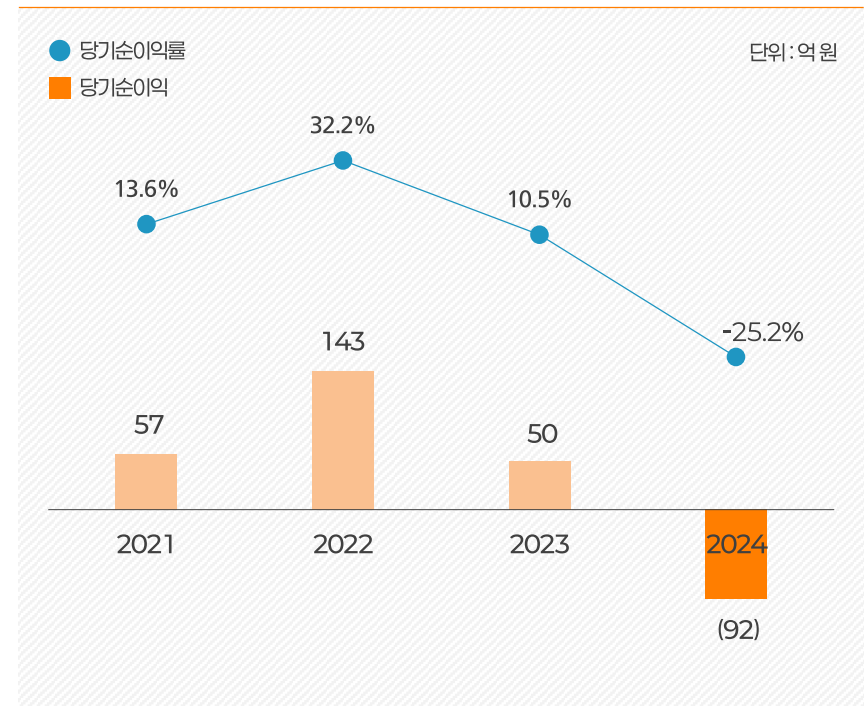
영업비용 증가와 전방산업 침체로 영업이익/당기순이익 적자전환

- » 영업손익 : 전년 대비 M/C 등 설비 증설에 따른 감가상각비 등 비용 65.7억 증가하여 적자 전환
- » 금융손익 : 차입금 증가로 이자비용 증가하였으나, 전환사채 평가에 따른 기저효과로 10.2억 이익 발생
- » 유형자산 처분 기저효과, 법인세 환급효과 등 18.2억 반영

### 영업이익(률)



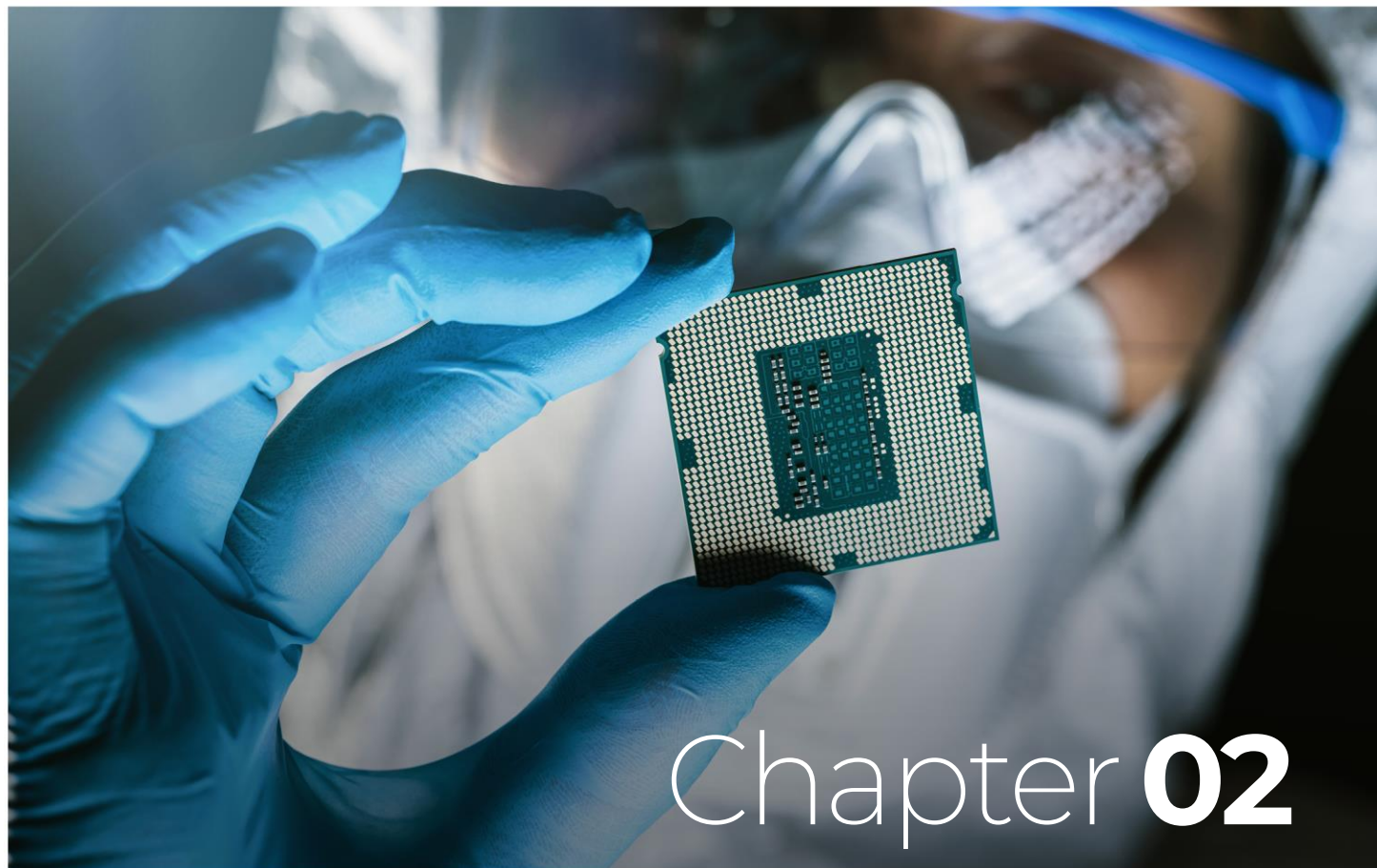
### 당기순이익(률)



주: K-IFRS 연결 기준

## 주요 기술력 및 경쟁력

1. ALT 비메모리 반도체 공정 영역
2. 공정 소개 ① Probe Test
  - ② Ring(Rim) Cut
  - ③ Recon(CIS 등)
  - ④ Package
3. 투자현황



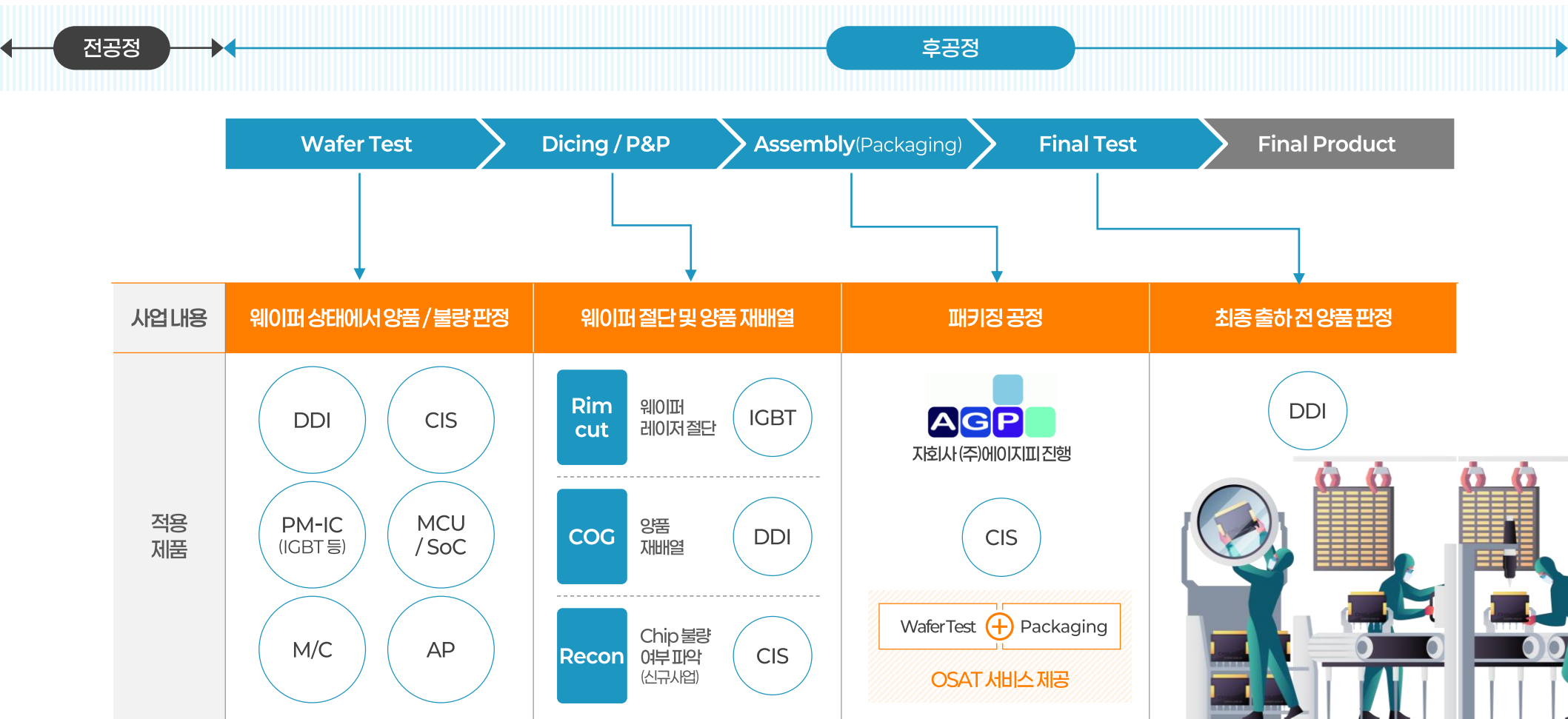
## Chapter 02



# 01. ALT 비메모리 반도체 공정 영역

비메모리 반도체 후공정 토탈 솔루션 제공

■ ALT 사업 영역



## 02. 공정 소개 ① Probe Test

반도체 수율 향상을 위한 필수공정

Wafer Test

Dicing / P&P

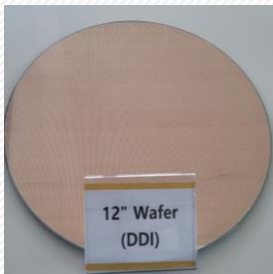
Assembly(Packaging)

Final Test

Final Product

### Probe Test Process

Wafer 상태의 Chip의 양품 선별공정으로, Chip의 불량 식별 및 설계상의 문제점을 발견해 개선하는 공정으로,  
반도체 수율 향상을 위해 반드시 필요한 솔루션



DDI Wafer

**웨이퍼 투입**

Prober에 투입,  
자동검사

**적용제품**

DDI, CIS, PM-IC, M/C,  
AP, MCU/SoC 등



TEST LINE



TESTER+PROBER

**Wafer Test**

Chip의 양품 / 불량 여부 및 고유값 측정



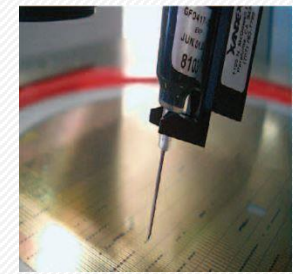
PROBER



AVI

**AVI 검사**

외관상 이물, 기타 특이사항  
검사



INKING

**잉킹**

불량 칩에 잉크로 표시

## 02. 공정 소개 ② Ring(Rim) Cut

PM-IC(IGBT 등) 웨이퍼 테스트 및 국내 유일 Rim Cut 기술을 Turnkey로 제공

Wafer Test

Dicing / P&P

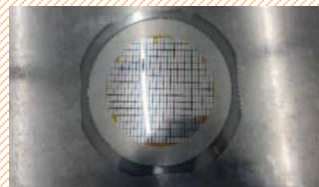
Assembly(Packaging)

Final Test

Final Product

### Ring(Rim) Cut Solution

국내 최초로 Laser Cut 방식을 도입, Kerfwidth 최소화 Net Die 손실을 줄이는 Taiko Wafer 테두리 절단 분리 솔루션



#### Full Auto System

5개 공정을 1개 공정으로 단축, Handling 과정에서 발생하는 Wafer Damage 발생 근본적으로 해소



#### Taiko Wafer

Wafer 안쪽을 얇게(70 $\mu$ m) 갈아내고,  
테두리는 두껍게 남겨놓는 가공공법

#### Blade Saw

절단폭이 넓어 Net Die 수량 감소  
파편에 의한 Chip 손상으로 수율 감소

#### Laser Cut

절단폭 최소화, Net Die 최대화  
열손상 및 파편에 의한 Chip 손실 예방



## 02. 공정 소개 ③ Recon(CIS 등)

양품 체크 및 성능별 칩 재배열 기술을 Turnkey로 제공해 사업 확장 실현

Wafer Test

Dicing / P&P

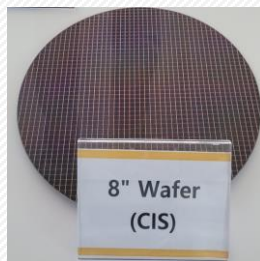
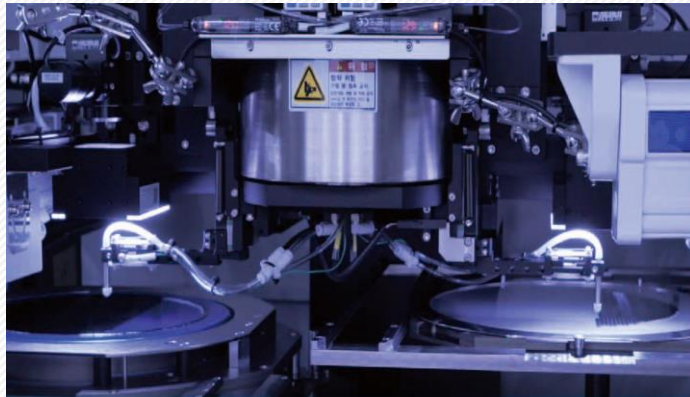
Assembly(Packaging)

Final Test

Final Product

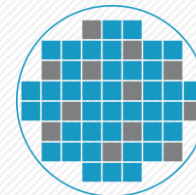
### Recon : Wafer Reconstruction

Sawing 후 양품 Chip을 Pick Up하여 고객 요청에 맞추어  
Wafer 형태로 테이프에 재배치하는 솔루션



### COG

DDI칩 Sawing 후 고객이 원하는 양품칩만을 Tray에 재배열



■ 양품 chip  
■ 불량 chip

Wafer 사이즈별 재배열

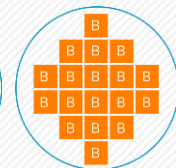
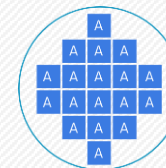
8인치, 12인치 웨이퍼,  
\*경박단소 필요제품 재배열 가능

고품질 생산 시스템 구축

Turnkey 서비스 제공  
생산 표준화 MES 시스템 구축

### Recon

Wafer Test 후 선별된 양품 Chip 성능별 구분 및 재배열



성능별 Chip 재배열

빠른 후속 공정 가능

One Stop 솔루션 제공

Test - Back Grinding  
- Sawing - Recon

## 02. 공정 소개 ④ Package

CLCC(고신뢰성 세라믹 패키지), PLCC(플라스틱 패키지) 조립 및 테스트 공정

Wafer Test

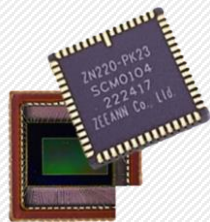
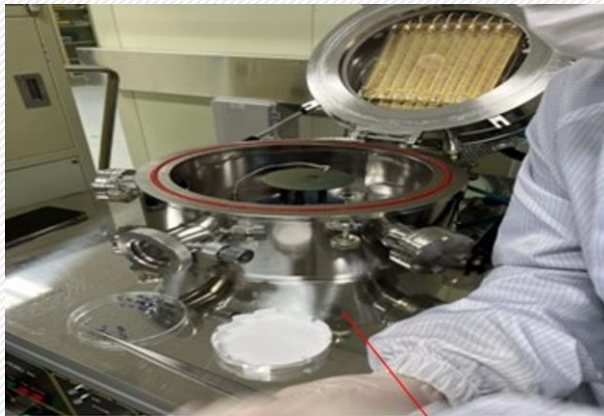
Dicing / P&P

Assembly(Packaging)

Final Test

Final Product

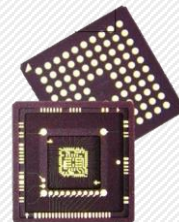
### Automotive & Military Sensor



CLCC  
일반용



A\_BGA  
전장 및 방산용



MCP  
멀티칩

### CIS

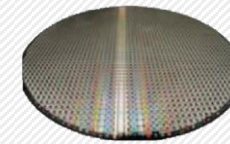
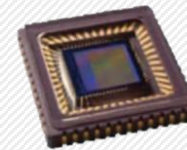
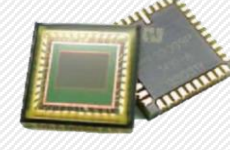


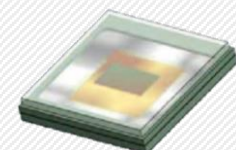
IMAGE SENSOR WAFER



CLCC  
세라믹 바디



PLCC  
플라스틱 바디



BGA  
볼 리드

### Appilcation

AUTOMOTIVE



SECURITY



PC CAM



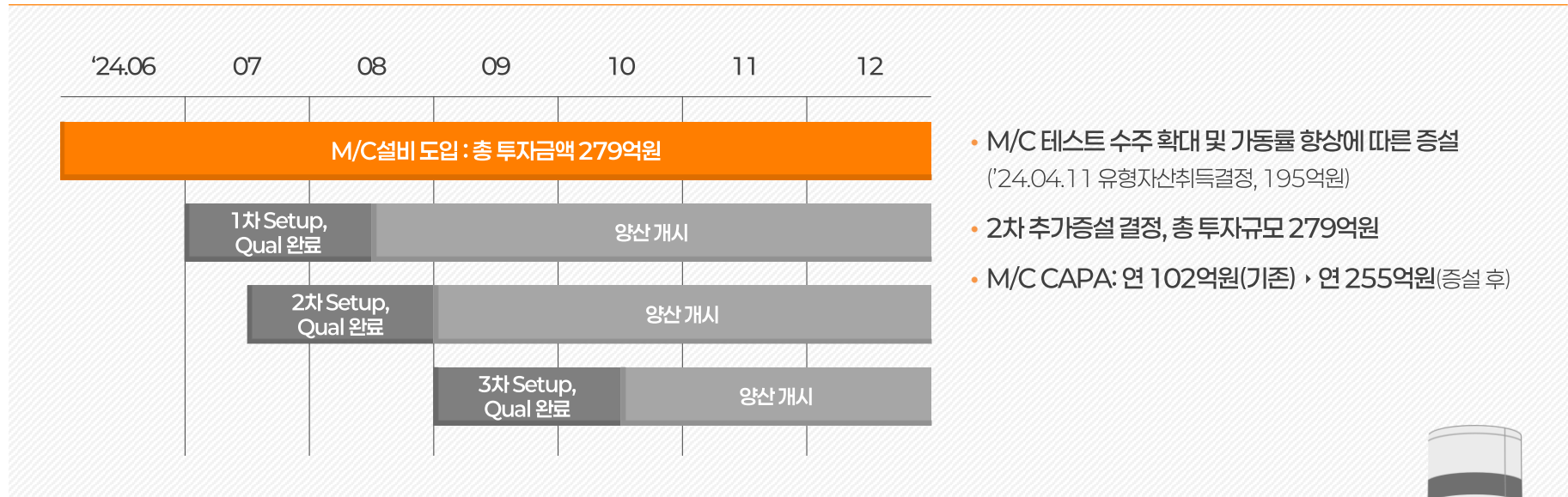
DIGITAL CAM



### 03. 투자현황

신규 테스트 장비 증설과 신공장 건설을 통한 CAPA 확대 등 외형성장 가속화

#### M/C 테스트 장비 증설(완료)



#### 신공장 건설

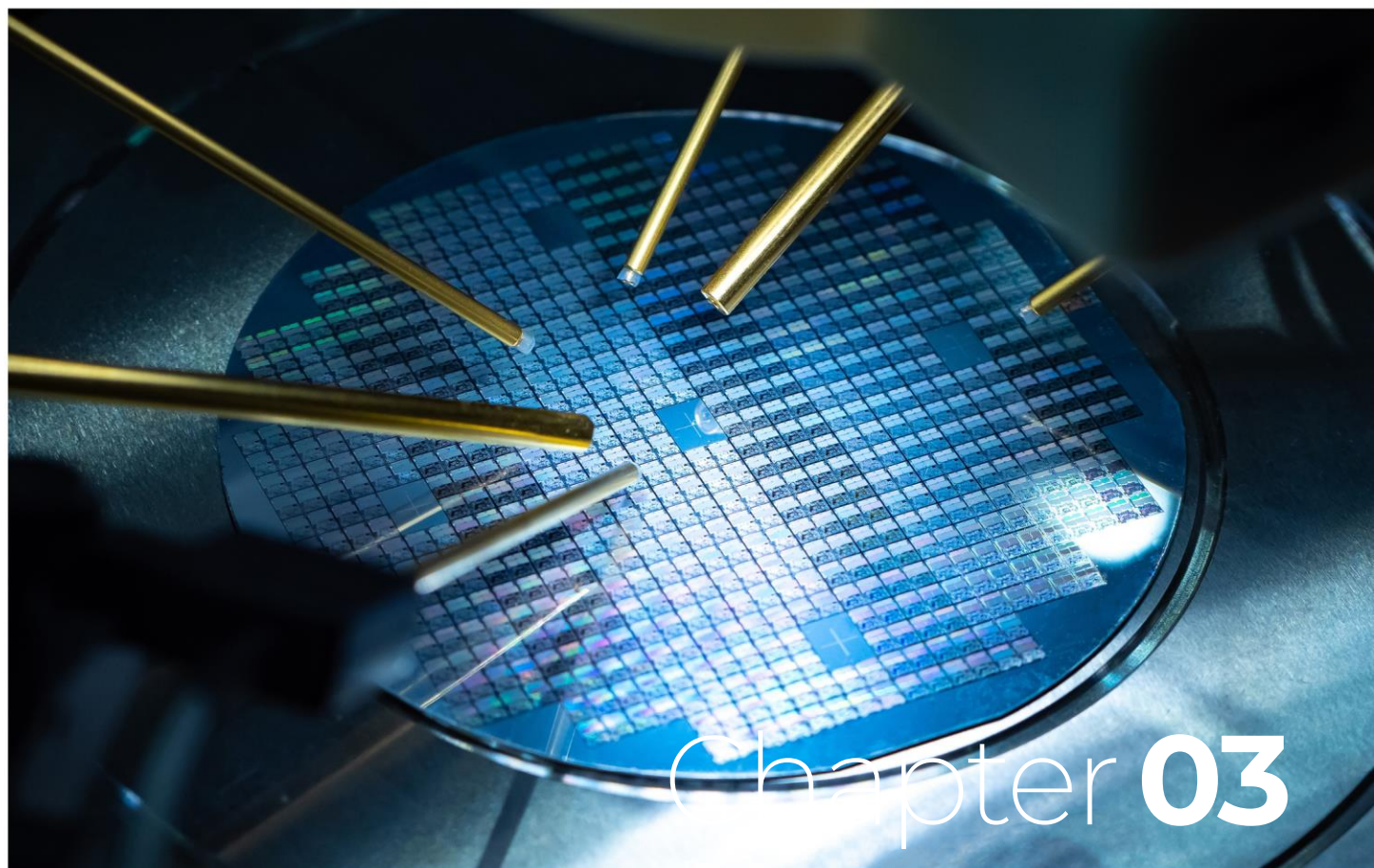
- » M/C, CIS, AP 등 테스트 CAPA 확대를 위한 신공장 부지 매입 ('24.04.11 신규시설투자등)
- » '25 연내 착공 목표로 설계 중. '26년 준공 및 양산 목표 (1차 1,144억원 규모 CAPA 확보)





## 성장전략 및 비전

1. ALT 성장 로드맵
2. 기술 기반 기존 사업 확대 본격화
3. 선제적 신규기술 개발 추진
4. 신규 사업영역 확장
5. Vision



Chapter 03

## 01. ALT 성장 로드맵

신기술 개발 및 신규 수주 기반으로 지속적인 성장 모멘텀 확보

### 에이엘티 성장로드맵



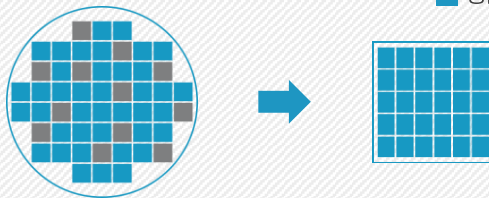
## 02. 기술 기반 기존 사업 확대 본격화

Wafer Test외 양품 체크 및 성능별 칩 재배포 기술을 Turnkey로 제공해 사업 확장 실현

### COG

DDI칩 Sawing 후 고객이 원하는 양품칩만을 Tray에 재배포하는 사업

■ 양품 chip ■ 불량 chip



#### COG 경쟁력

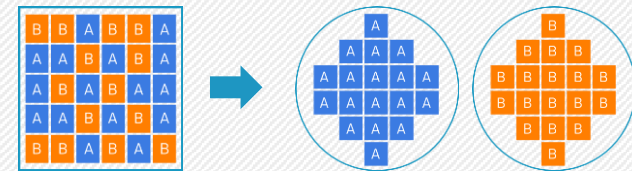
Wafer 사이즈별 재배포  
8인치, 12인치 웨이퍼,  
\*경박단소 필요제품 재배포 가능



고품질 생산 시스템 구축  
Turnkey 서비스 제공  
생산 표준화 MES 시스템 구축

### Recon

Wafer Test 후 선별된 양품 Chip 성능별 구분 및 재배포



#### Recon 경쟁력

성능별 Chip 재배포  
빠른 후속 공정 가능



One Stop 솔루션 제공  
Test - Back Grinding  
- Sawing - Recon

#### 기대효과



1. 납기 단축

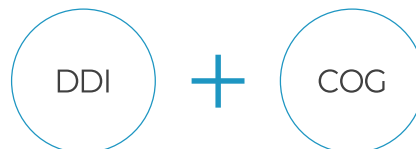


2. 수율 향상



3. 원가 절감

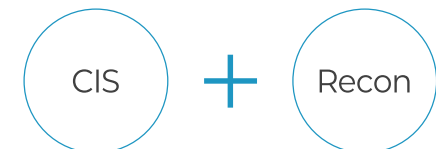
DDI 후공정 사업과 기술 시너지 기대



#### 신규 고객사 지속 확보

비메모리 반도체 후공정 + 기술  
포트폴리오 구축

CIS 후공정 사업과 기술 시너지 기대



\* 경박단소: 가볍고, 얇고, 짧고, 작은 형태



### 03. 선제적 신규기술 개발 추진

신규 Test 시장 확대에 따른 차세대 전력반도체(SiC 등) 신기술 개발로 시장 선점

SiC 차세대 전력 반도체 시장 전망

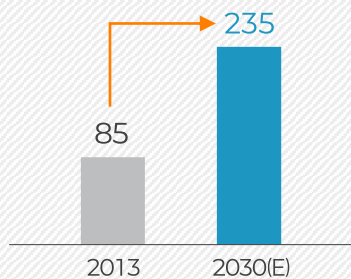
단위: 십억 달러



자료: Markets and Markets

글로벌 신재생에너지 시장

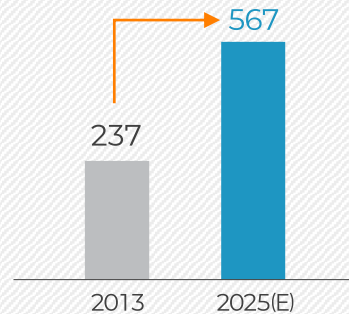
단위: GW



자료: New Energy Finance

글로벌 전기차 시장

단위: 십억 달러



자료: Statista

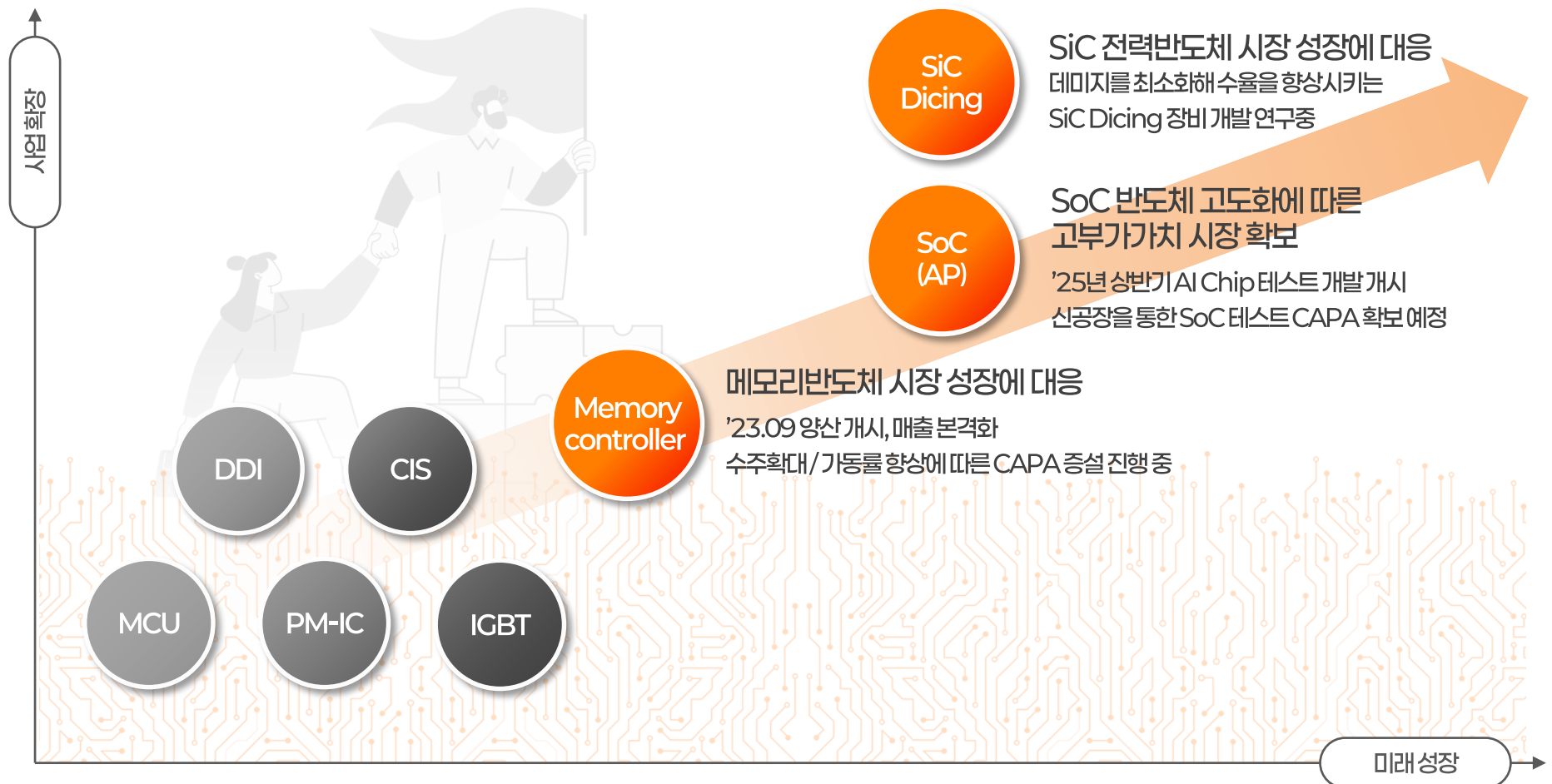
#### ALT Rim cut 신규기술 개발 추진

Si 반도체에만 적용되는 ALT의 Rim cut 기술을  
SiC 반도체에 응용하여 신규 개발 추진

Si	구분	SiC
기술 상용화 완료	ALT Rim cut	기술 개발 추진
국내 유일	ALT Dicing 시장 포지션	기술 개발 완료 시 시장 선점

## 04. 신규 사업영역 확장

Memory Controller, SoC 등 고부가가치 테스트 품목으로 사업영역 다변화





## 비메모리 반도체 OSAT 선도기업



## 국내 비메모리 반도체 후공정 테스트 선도 기업

다변화된  
사업포트폴리오 구축

차별화된  
기술력 구축

고객 맞춤형 제품 생산의  
최적화 솔루션 제공

다양한  
고객사 확보

## APPENDIX

1. 2024년 4분기 매출액
2. 2024년 4분기 영업이익/당기순이익
3. 실적 요약
4. 실적 요약
5. 요약 재무제표



# Appendix

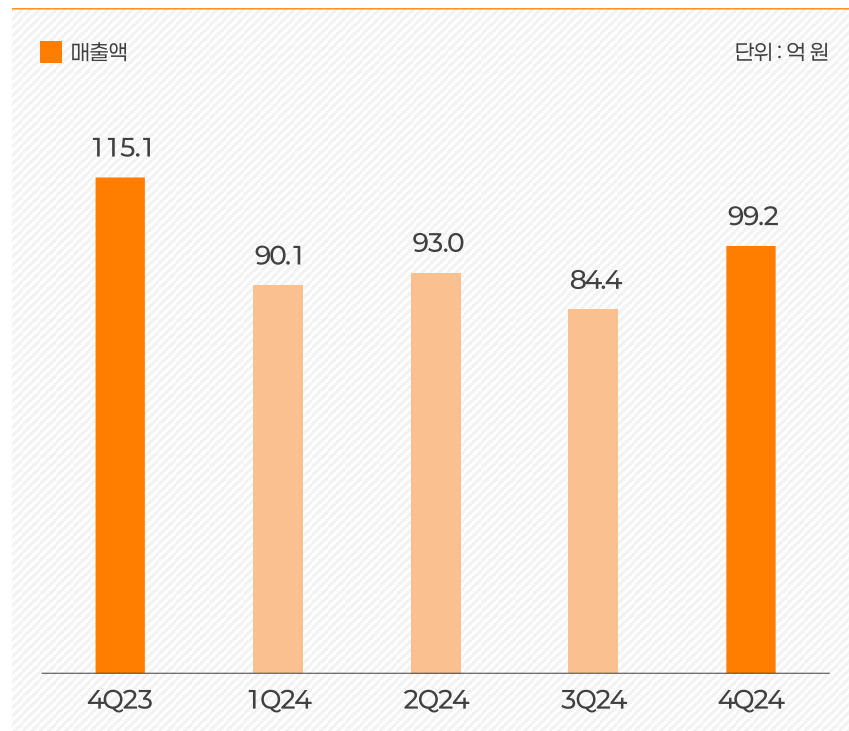


## 01. 2024년 4분기 매출액

IT제품 수요 회복 지연 등으로 매출액 15.9억(-13.8%) 감소

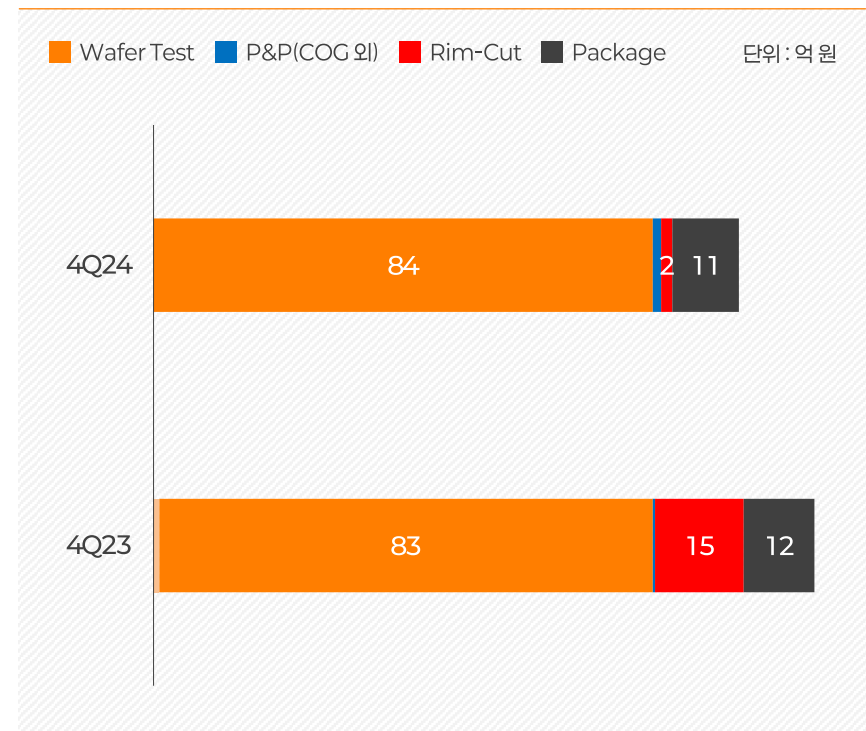
- » Test 매출 : 전년 동기 대비 매출액 3.2억(-3.7%) 감소
- » 기타 매출 : 전년 동기 대비 매출액 12.7억(-46.6%) 감소

### 매출액 추이



주: K-IFRS 연결 기준

### 전년동기 대비 사업부별 매출액

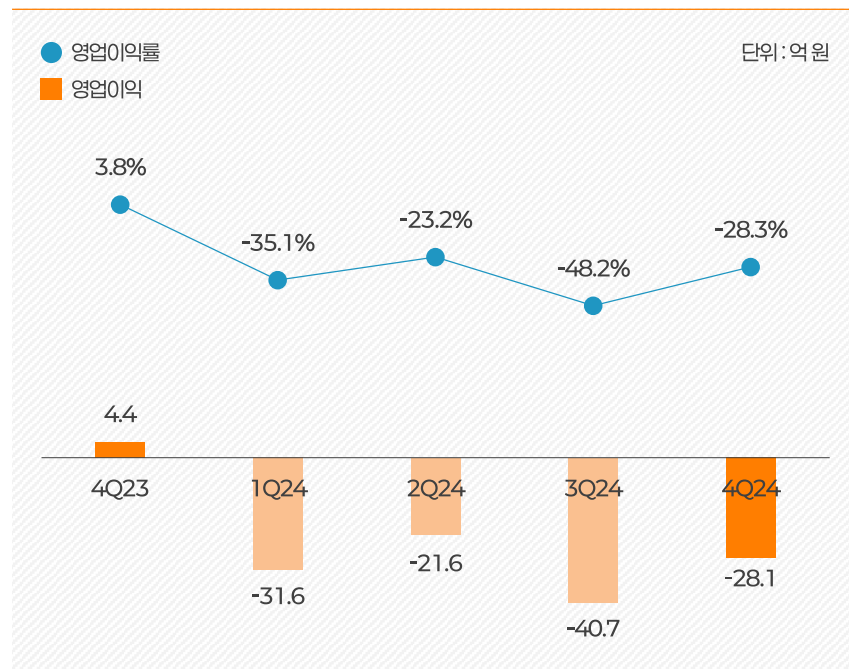


## 02. 2024년 4분기 영업이익/당기순이익

영업비용 증가와 전방산업 침체로 4Q23 대비 영업이익/당기순이익 적자전환

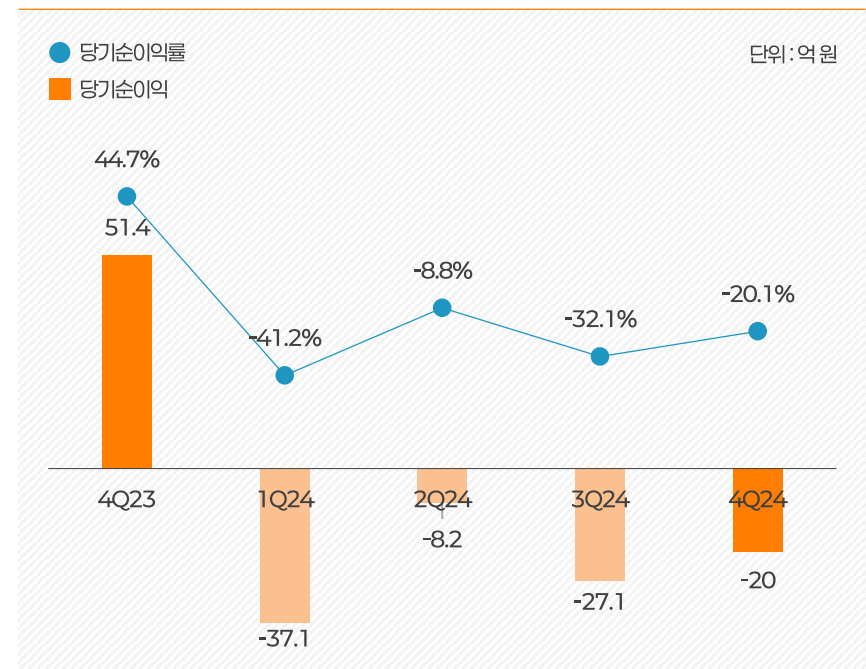
- » 영업비용 증가: 전년 동기 대비 M/C 등 설비 증설에 따른 감가상각비 등 비용 20.3억 증가
- » 금융비용 증가: 설비투자에 따른 차입금 증가로 이자비용, 전환사채 평가에 따른 손실 등 9.3억 증가
- » 유형자산 처분 기저효과, 법인세 환급효과 등 9.7억 반영

### 영업이익(률)



주: K-IFRS 연결 기준

### 당기순이익(률)



### 03. 실적 요약

(단위 : 억 원)	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	YoY	QoQ
매출액	115.1	90.1	93.0	84.4	99.2	-13.8%	+17.5%
Wafer Test	83.0	75.9	76.7	67.4	84.7	-3.7%	25.7%
Rim-Cut	14.9	1.7	2.5	3.6	1.9	-87.0%	-47.0%
P&P(COG 외)	0.4	0.7	0.8	1.2	1.4	219.7%	14.3%
Packaging	11.9	11.7	13.0	12.2	11.2	-5.7%	-8.0%
매출원가	99.1	109.7	102.2	113.4	117.5	18.5%	3.6%
판매비와관리비	11.6	12.0	12.5	11.7	9.8	-15.1%	-16.1%
감가상각비와무형자산상각비*	47.5	50.1	50.8	53.0	57.0	20.0%	7.5%
영업이익	4.4	-31.6	-21.6	-40.7	-28.1	적자지속	적자지속
(영업이익률)	3.8%	-35.1%	-23.2%	-48.2%	-28.4%	-	-
이자비용	5.1	9.7	10.2	12.9	13.5	166.2%	4.9%
법인세비용	-41.6	-2.4	-21.5	-28.6	-21.9	-47.2%	-23.2%
당기순이익	51.4	-37.1	-8.2	-27.1	-20.0	적자지속	적자지속
(당기순이익률)	44.7%	-41.2%	-8.8%	-32.1%	-20.2%	-	-

\*감가상각비와무형자산상각비는 매출원가와 판매관리비에 계상된 금액을 합산한 값임